

产品指标

1650nm 宽带 SLED

➤ 特性

- 出纤功率 >8mW
- 典型3dB带宽60nm
- 典型光谱调制0.2dB
- 14-pin DIL和BTF两种封装
- 单模光纤

➤ 应用

- 光纤陀螺
- 光学测试设备
- 光纤传感
- 光纤通讯
- 光学相干影像
- 生物医疗影像设备
- 临床治疗设备

➤ 绝对最大值

参数	符号	条件	最小	最大	单位
反向电压	V_R			2	V
前向电流	I_F			400	mA
前向电压	V_F	I_{op}		2.5	V
箱体温度	T_c	I_{op}	-40	65	°C
SLED 温度	T_{SLED}	I_{op}	0	70	°C
TEC 电压	V_{TEC}			3	V
TEC 电流	I_{TEC}			1.8	A
储存温度	T_{stg}	无偏袒的	-40	85	°C
储存湿度			5	85	%RH
静电放电 (ESD)	V_{ESD}	人体模式		500	V
引脚焊接温度	S_{temp}			260	°C
引脚焊接时间	S_{time}			10	sec

➤ 指标参数(TSLED = 25 °C)

参数	符号	条件	最小	典型	最大	单位
工作电流	I_{op}				350	mA
前向电压	V_F	I_{op}			2	V
单模光纤中的功率	P_o	I_{op}	8			mW
中心波长	λ	I_{op}	1635	1650	1665	nm
带宽	B_{FWHM}	I_{op}	55	60		nm
光谱调制	R	I_{op}		0.2	0.4	dB
热敏电阻	R_{therm}	$T = 25\text{ °C}$	9.5	10	10.5	kΩ
TEC电压	V_{TEC}	I_{op}			2.5	V
TEC电流	I_{TEC}	I_{op}			1.1	A

(1) T_{SLED} 是内部热敏电阻监视得到并由外部引脚输出的。

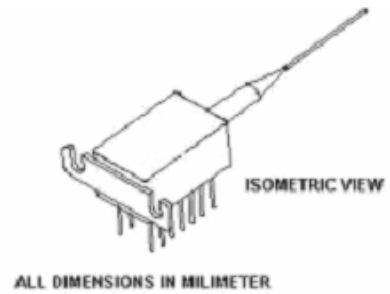
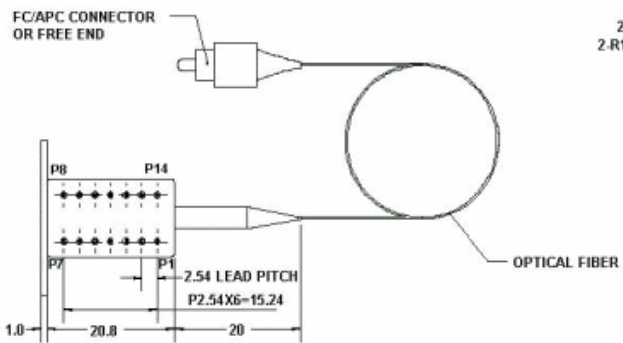
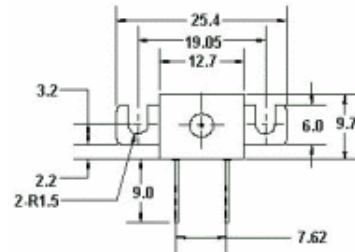
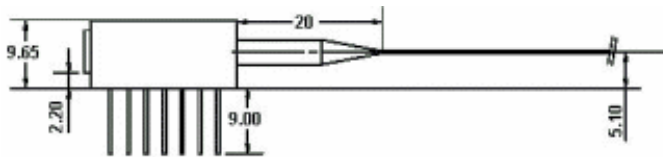
➤ 封装

部件	描述
封装类型	BTF
光纤	SMF-28

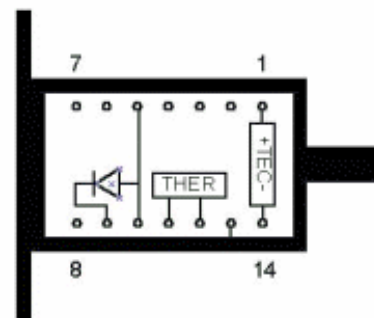
产品指标

MFD	10 μ m
包层直径	125 μ m
涂覆层直径	245 μ m
保护套	900 μ m松套管
尾纤长度	1m
光纤盘曲直径	>40mm
连接头	FC/APC
尺寸	见图

► DIL型封装尺寸

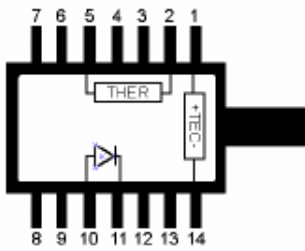
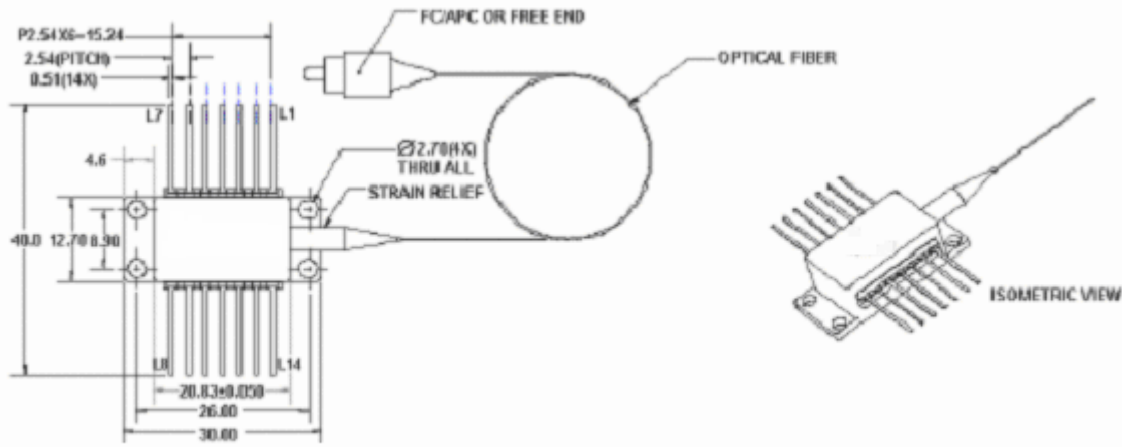


1	TEC+	8	无
2	无	9	SLED 阴极-
3	无	10	SLED 阳极+
4	无	11	热敏电阻
5	SLED 阳极+	12	热敏电阻
6	无	13	外壳
7	无	14	TEC-



产品指标

蝶型封装尺寸

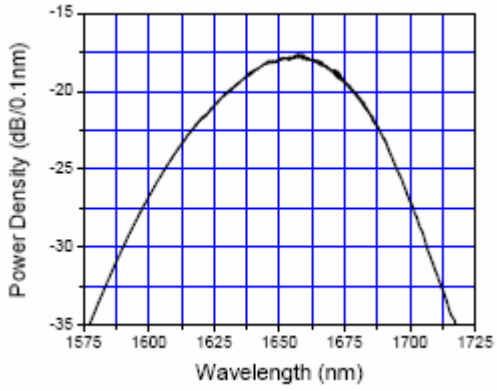


1	TEC+	8	无
2	热敏电阻	9	无
3	无	10	SLED 阳极+
4	无	11	SLED 阴极-
5	热敏电阻	12	无
6	无	13	外壳
7	无	14	TEC-

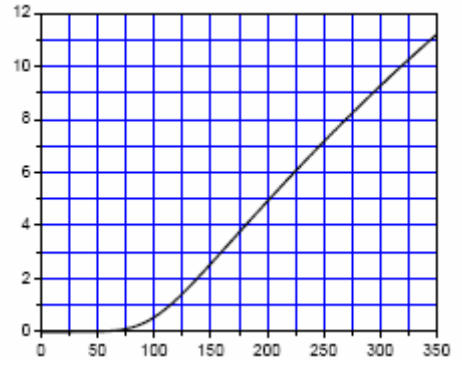
管脚定义

典型性能特征

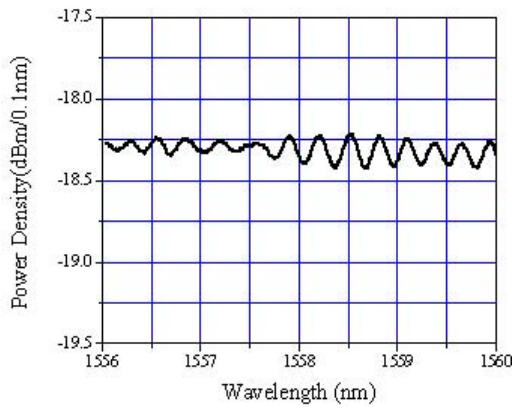
工作条件: $T_{\text{SLED}} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$



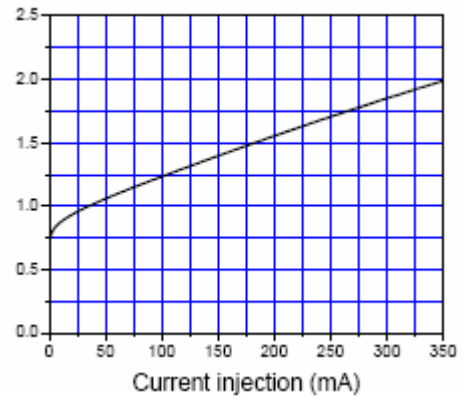
发射光谱曲线



P-I 曲线



光谱调制



I-V 曲线